

POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ

OPIS PATENTOWY

Nr 47948

Kl. 21 g, 10/02
Kl. internat. H 01 g

Instytut Tele-i Radiotechniczny*)

Warszawa, Polska

Obudowa do kondensatorów stałych

Patent trwa od dnia 23 listopada 1962 r.

Wynalazek dotyczy obudowy do kondensatorów stałych, która pozwala na zautomatyzowanie procesu zamykania kondensatorów. Kondensatory zwijane względnie składane z folii przekładanej miką wykonuje się w ten sposób, że gotową zwijkę lub stos umieszcza się w obudowie w postaci rurki, kubka okrągłego albo czworobocznego, którą następnie zamyka się od czoła przez zalewanie, zaprasowywanie, saterowanie itp.

Sposób według wynalazku polega na wykonaniu obudowy składającej się z dwóch jednakowych połówek, z których każda ma kształt korytka powstałego z podziału obudowy kondensatora wzdłuż jego osi. Fig. 1 przedstawia korytko jako obudowę do kondensatorów zwijanych, korytko ma kształt połówki walca, a fig. 2 ramkę do kondensatorów składanych w postaci stosu.

*) Właściciel patentu oświadczył, że twórcą wynalazku jest mgr inż. Przemysław Chrobak.

Do wykonania korytek 1 i 2 stosuje się tworzywa termoplastyczne np. polistyren, polietylen, poliwęglany itp. lub termoutwardzalne np. bakelit uszlachetniany względnie tworzywo melaminowe.

W korytkach można umieszczać zwijki kondensatorów papierowych, elektrolitycznych nasyconych lub przeznaczonych do zaimpregnowania.

Brzegi korytek z materiału termoplastycznego mają wąską krawędź 3 służącą dla zwiększenia powierzchni styku obydwóch połówek i pozwalającą na sklejenie względnie spawanie lub spiekanie ze sobą połówek obudowy po umieszczeniu w niej zwijki.

Na brzegach korytek z materiału termoutwardzalnego wykonuje się występy 4, pozwalające na złożenie i sklejenie obydwu połówek.

Przy stosowaniu obudowy z tworzywa termoutwardzalnego impregnację kondensatorów syciwem epoksydowym można wykonać równocześnie z zamykaniem kondensatora. W tym

celu obie połówki obudowy z umieszczoną wewnątrz zwijką zaciska się prowizorycznie a następnie wkłada się do syciwa żywicznego i impregnuje się pod próżnią.

Po wyjęciu i obcieknięciu syciwa utwardza się kondensatory w odpowiednim piecu.

W obudowie można umieszczać zwijki posiadające dwustronne wyprowadzenia poosiowe lub umieszczone jednostronnie obok siebie. Równocześnie z procesem zamykania obudowy uszczelnia się przejście obydwóch wyprowadzeń przez obudowę.

W celu wykonania kondensatora w obudowie termoplastycznej zwijkę zaimpregnowaną umieszcza się w jednej połówce obudowy a drugą przykrywa się z wierzchu. Przy pomocy odpowiedniej elektrody spawa się obie połówki ze sobą, przy czym nadmiernie wystająca część brzegu odpada.

Można stosować również zatapianie płomieniowe względnie odpowiednio uformowaną

elektrodę spawającą obejmującą wokół obudowę kondensatora.

Zastosowanie obydwóch typów obudowy pozwala na zautomatyzowanie procesu produkcji kondensatorów.

Zastrzeżenia patentowe

1. Obudowa do kondensatorów stałych znamienna tym, że składa się z dwóch symetrycznych połówek (ramek, korytek), których linia podziału leży w płaszczyźnie przechodzącej przez oś podłużną kondensatora.
2. Obudowa według zastrz. 1 znamienna tym, że brzegi jej zaopatrzone są w krezę lub występy pozwalające na łączenie obu połówek ze sobą.

Instytut Tele- i Radiotechniczny

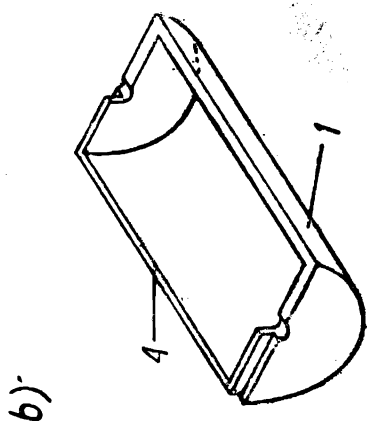


Fig. 1

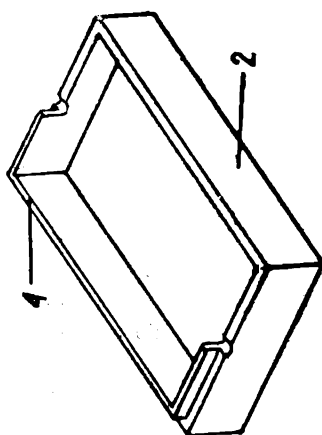


Fig. 2

